



**Okamoto**

**株式会社岡本工作機械製作所**  
(証券コード：6125)

**2026年3月期第2四半期  
決算説明会資料**

**2025年12月4日**

## **アジェンダ**

- 1. 2026年3月期第2四半期決算概況と  
2026年3月期業績予想**
- 2. 中期経営計画“INFINITY700”  
進捗状況**

**Appendix**

# 1. 2026年3月期第2四半期決算概況と 2026年3月期業績予想

# 決算サマリ

## 業績

- ✓ 売上高201億17百万円、営業利益8億85百万円
- ✓ 売上高は昨年同期好調だった大型平面研削盤の販売減少などの影響を受けるも、半導体関連装置がそれを補い前年同期比微増、営業利益は微減

## 受注実績

- ✓ 半導体関連装置は国内や東アジア向けにファイナルポリッシャーの受注を獲得、前年同期比を上回る
- ✓ 工作機械も各種補助金の後押しもあり、更新需要やロボット向け精密歯車好調
- ✓ 海外では米国は横這いも欧州は米国関税政策の影響から景気が下向き前年同期比減少
- ✓ 中国は車載カメラ需要の高まりからレンズ用向け平面研削盤を複数台受注



# 市場概況

## ■ 国内市場

- 工作機械は中小企業の設備投資を支援する補助金の効果もあり、小型及び中型平面研削盤の更新需要を取り込む。ロボット向け精密歯車も需要が高まり好調
- 一方で前年同期好調だった大型平面研削盤の販売が減少
- 半導体は設備投資需要が一部低迷も、通信技術の発達やIoT、生成AI関連分野、自動運転の本格化など今後の成長を期待。次世代パワー半導体、次世代高周波通信デバイス向けの半導体ウェーハなどで一部需要の兆し

## ■ 海外市場

- 北米市場は受注は前年同期とほぼ横ばいも、通商政策の駆け込み需要から売上は前年同期比を上回る
- 欧州は米国通商政策の影響から景気が下向き、売上・受注とも前年同期を下回る
- 中国ではEV車向けおよび自動運転をはじめとする車載カメラ需要の高まりを受けレンズ用金型向けで平面研削盤を複数台受注、売上は前年同期を下回る
- 半導体は欧州、東アジア向けにファイナルポリッシャーやグラインダを販売、受注も東アジア向けにファイナルポリッシャーの受注を獲得

## 業績ハイライト

(単位：百万円)

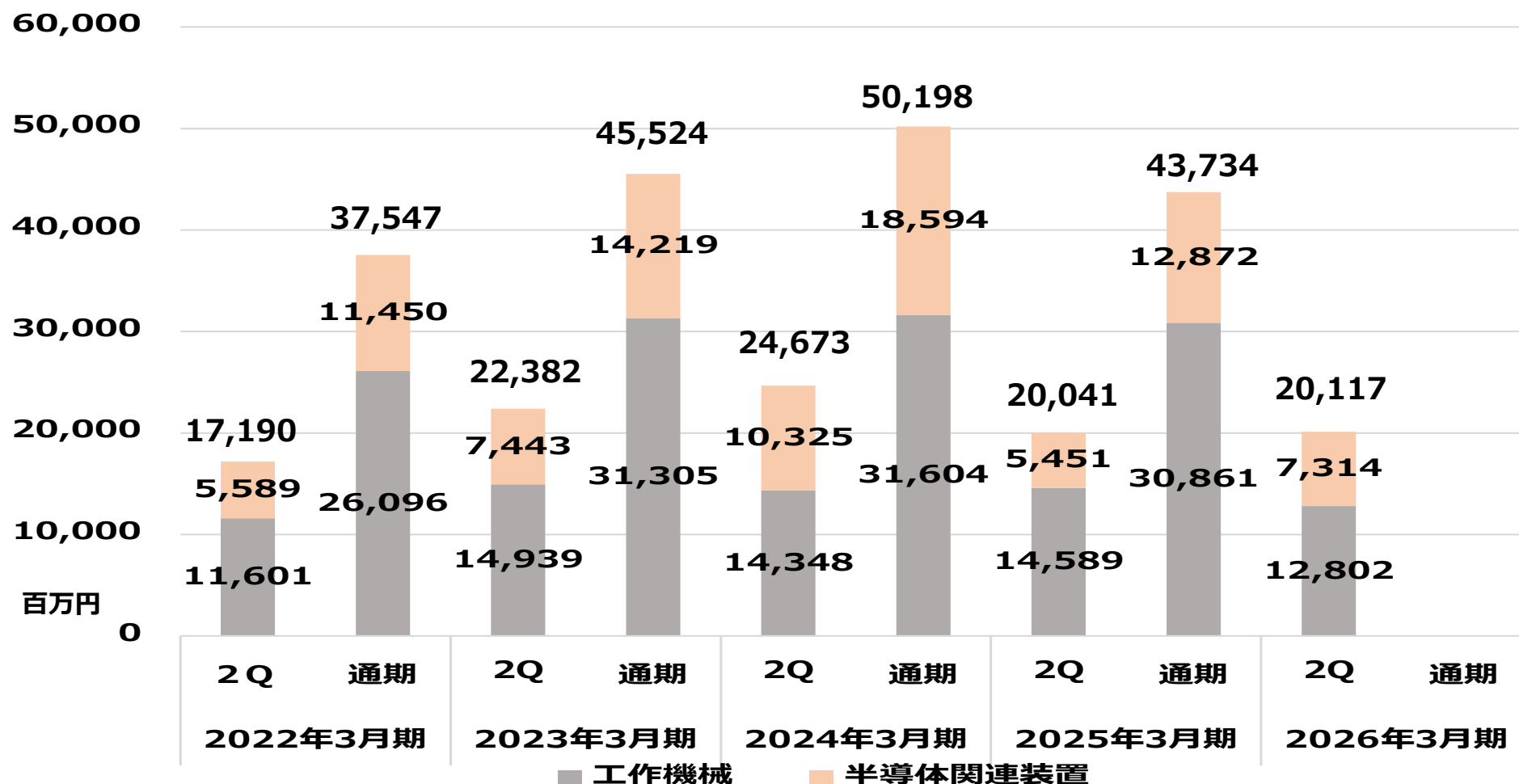
	2024年9月	2025年9月	
	金 額	金 額	前年同期増減率
売上高	20,041	20,117	+0.4%
売上総利益	5,719	5,750	+0.5%
販売費及び一般管理費	4,828	4,864	+0.7%
営業利益	891	885	▲0.6%
経常利益	525	863	+64.4%
中間純利益	312	458	+46.8%

為替レート	2025年 9 月	2026年3月 (計画)
米ドル	146.07	145.00
シンガポールドル	113.23	109.00
ユーロ	168.68	157.00
タイバーツ	4.47	4.20
人民元	20.34	20.40

※期中の平均レートで記載しております。

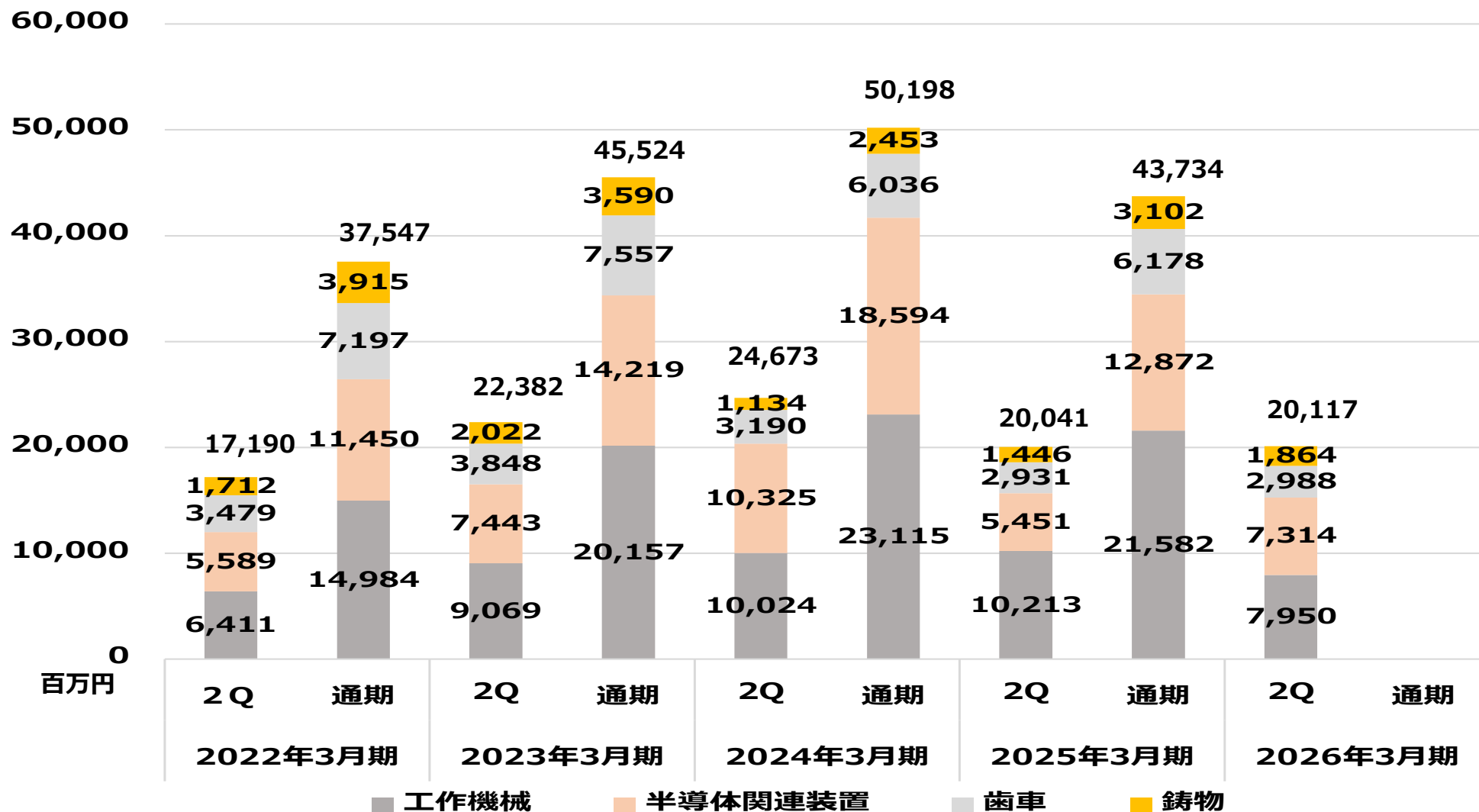
## セグメント別売上高推移①

工作機械は大型平面研削盤の販売が減少も半導体関連装置の売上は回復傾向に



# セグメント別売上高推移②

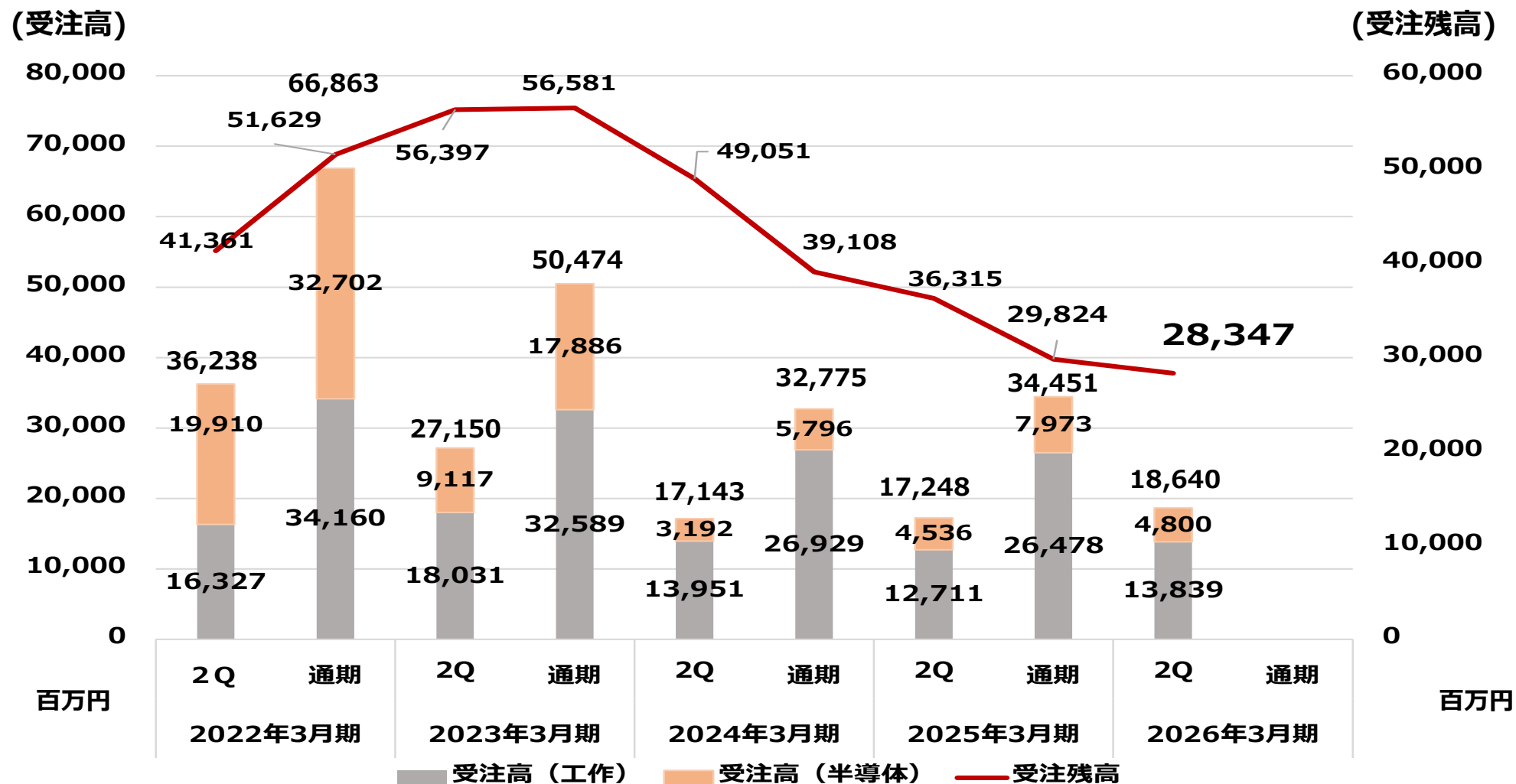
精密歯車はロボット向け需要が回復、鋳物も主要ユーザーからの需要が回復





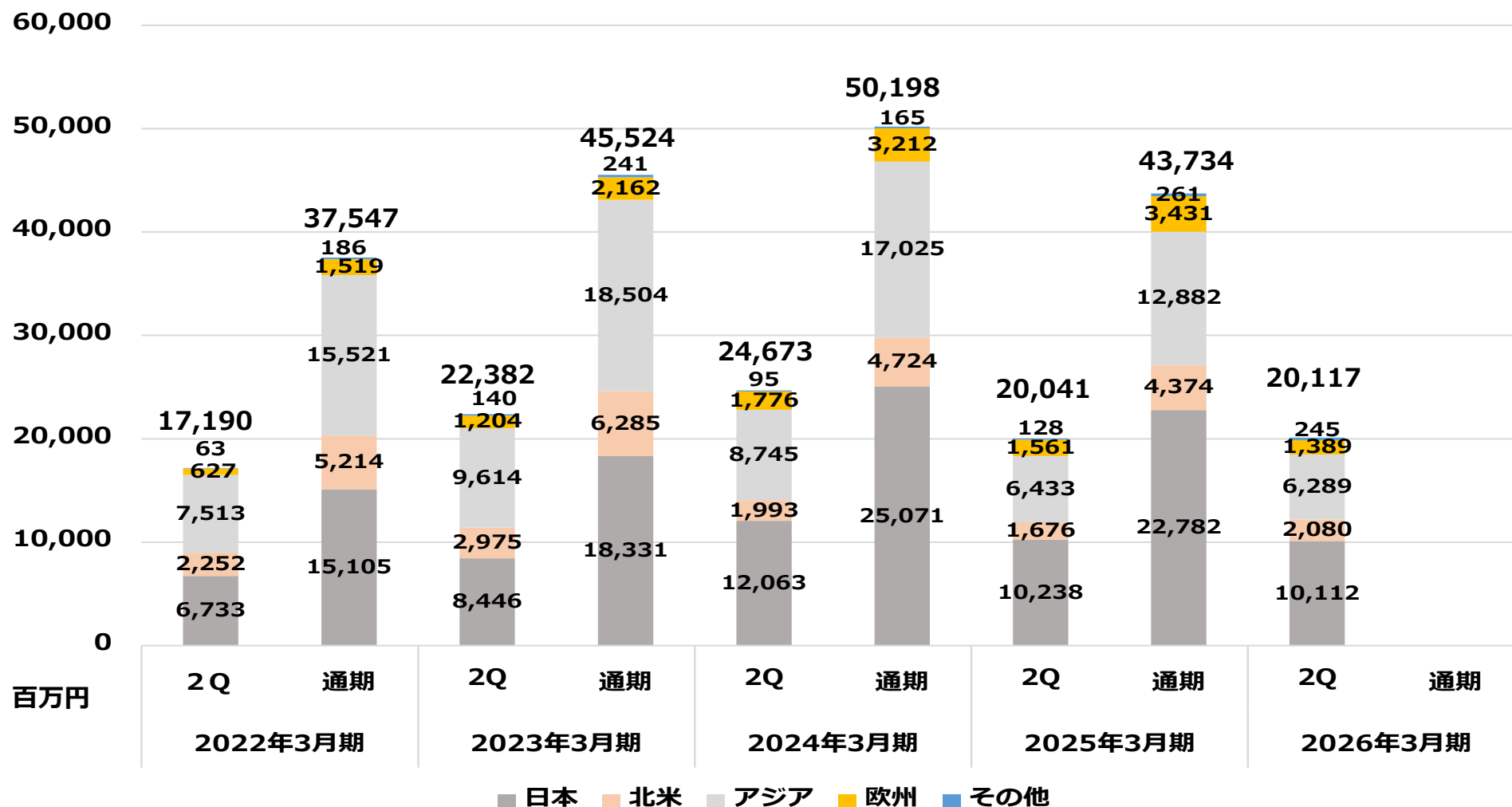
# 受注・受注残高

半導体関連装置を中心に特に7月～9月期において受注は回復傾向



# エリア別売上高推移

北米は通商政策に対する駆け込み需要で前年同期を上回る



## 比較貸借対照表

(単位：百万円)

		2025年3月	2025年9月	
		金額	金額	対前期末比
流動資産		47,214	42,251	▲4,963
	現金及び預金	9,899	9,894	▲5
	受取手形及び売掛金	11,156	10,333	▲823
	その他	26,159	22,024	▲4,135
有形・無形固定資産		17,350	18,672	+1,322
投資等		2,239	2,309	+70
資産合計		66,804	63,234	▲3,570

(単位：百万円)

		2025年3月	2025年9月	
		金額	金額	対前期末比
負債合計		26,241	22,292	▲3,949
	流動負債	19,874	16,400	▲3,474
	固定負債	6,366	5,891	▲475
純資産合計		40,563	40,942	+379
負債資本合計		66,804	63,234	▲3,570

## 比較キャッシュフロー計算書

(単位：百万円)

	2024年9月	2025年9月	
	金額	金額	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	▲2,999	1,477	+4,476
税金等調整前中間純利益	519	847	+328
減価償却費	1,020	1,030	+10
売上債権の増減（▲は増加）	1,322	918	▲404
棚卸資産の増減（▲は増加）	▲1,478	▲43	+1,435
仕入債務の増減（▲は減少）	▲1,798	▲220	+1,578
その他	▲2,584	▲1,055	+1,529
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲1,261	▲956	+305
財務活動によるキャッシュ・フロー	9,510	▲3,724	▲13,234
換算差額	▲75	207	+282
現金・現金同等物残高	16,592	11,726	4,866

# 2026年3月期業績予想

2026年3月期中間期は業績予想数値を修正（売上高で▲29億円、営業利益で▲4億2千万円）も、現時点で通期予想は変えず。引き続き海外販売強化や内製化率向上による変動費の抑制、固定費については経費削減の徹底を通じ目標の達成を期す

（単位：百万円）

	2025年3月	2026年3月 (予想)	
	金額	金額	増減率
売上高	43,734	50,000	+14.3%
営業利益	3,015	4,800	+59.2%
経常利益	2,916	4,700	+61.1%
当期純利益	2,024	3,000	+48.2%

## \* コスト構造の見直し

- ✓ 工作機械事業を中心とした戦略機種単価設定・拡販施策の見直し
- ✓ 購入部品・製作品のグローバル調達促進
- ✓ 生産拠点での生産性向上
- ✓ 内製化率の向上による外注費率の抑制 など

（単位：百万円）

	2025年3月	2026年3月 (予定)
	金額	金額
設備投資額	3,923	5,252
減価償却費	2,082	2,106
研究開発費	132	121
為替レート	2025年3月	2026年3月 (計画)
米ドル	152.57	145.00
シンガポールドル	113.98	109.00
ユーロ	163.66	157.00
タイバーツ	4.40	4.20
人民元	21.12	20.40

※期中の平均レートで記載しております

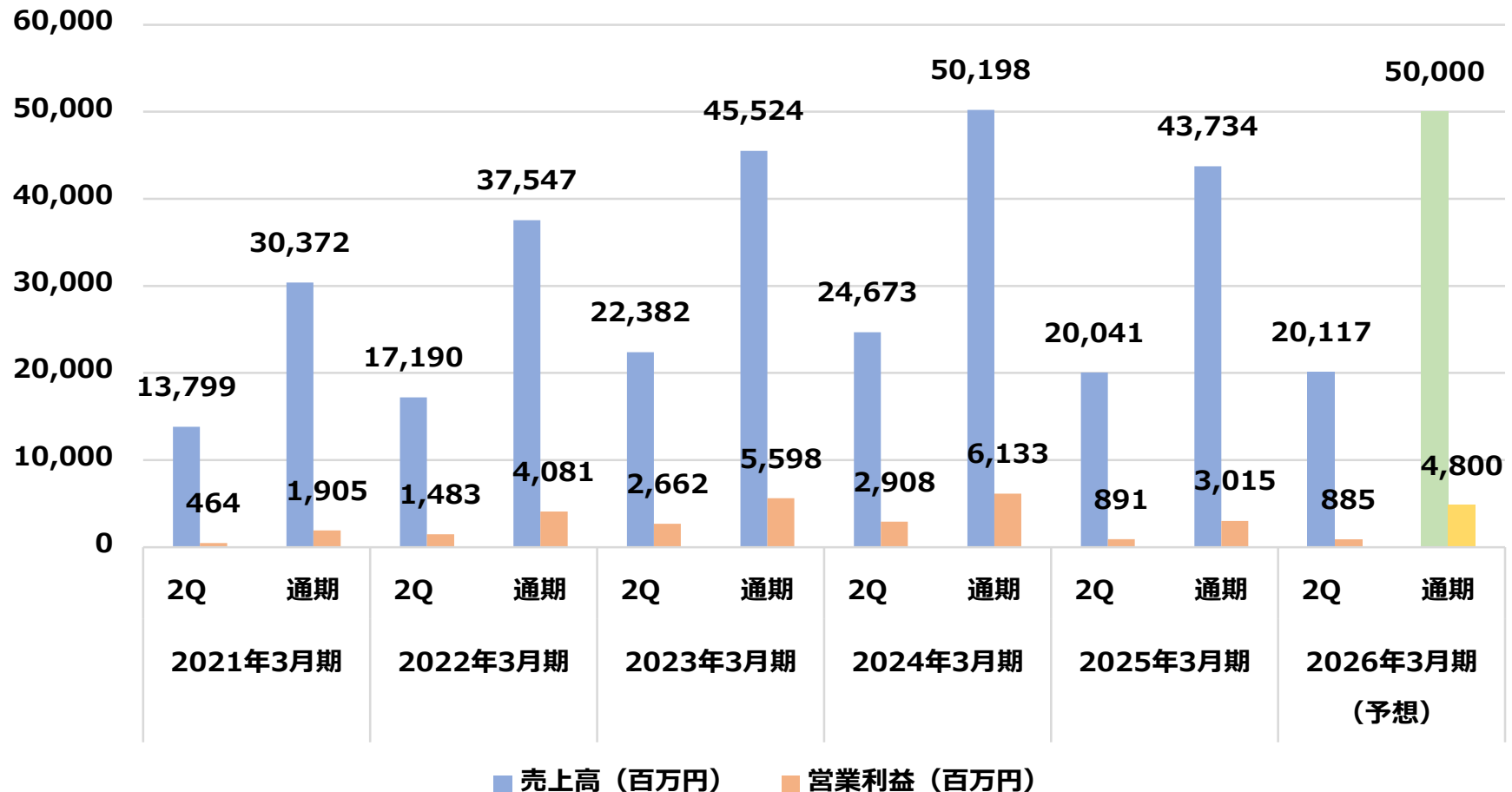
## コスト構造の見直し 取組み事例

- ✓ 納期対応の航空機輸送利用や外注利用を抑制するための管理を徹底
- ✓ 日本、タイ、シンガポールで複数購入先のある部品について3拠点間での相見積もりを実施。価格の安い拠点での調達に切り替えを促進
- ✓ 安中工場で生産していた機種を1機種、より安いコストで生産可能なタイ工場に生産を移管
- ✓ 長年の課題であった機種の統廃合につき全体像の検討を行い、本格的なコストダウンに着手



# 業績推移

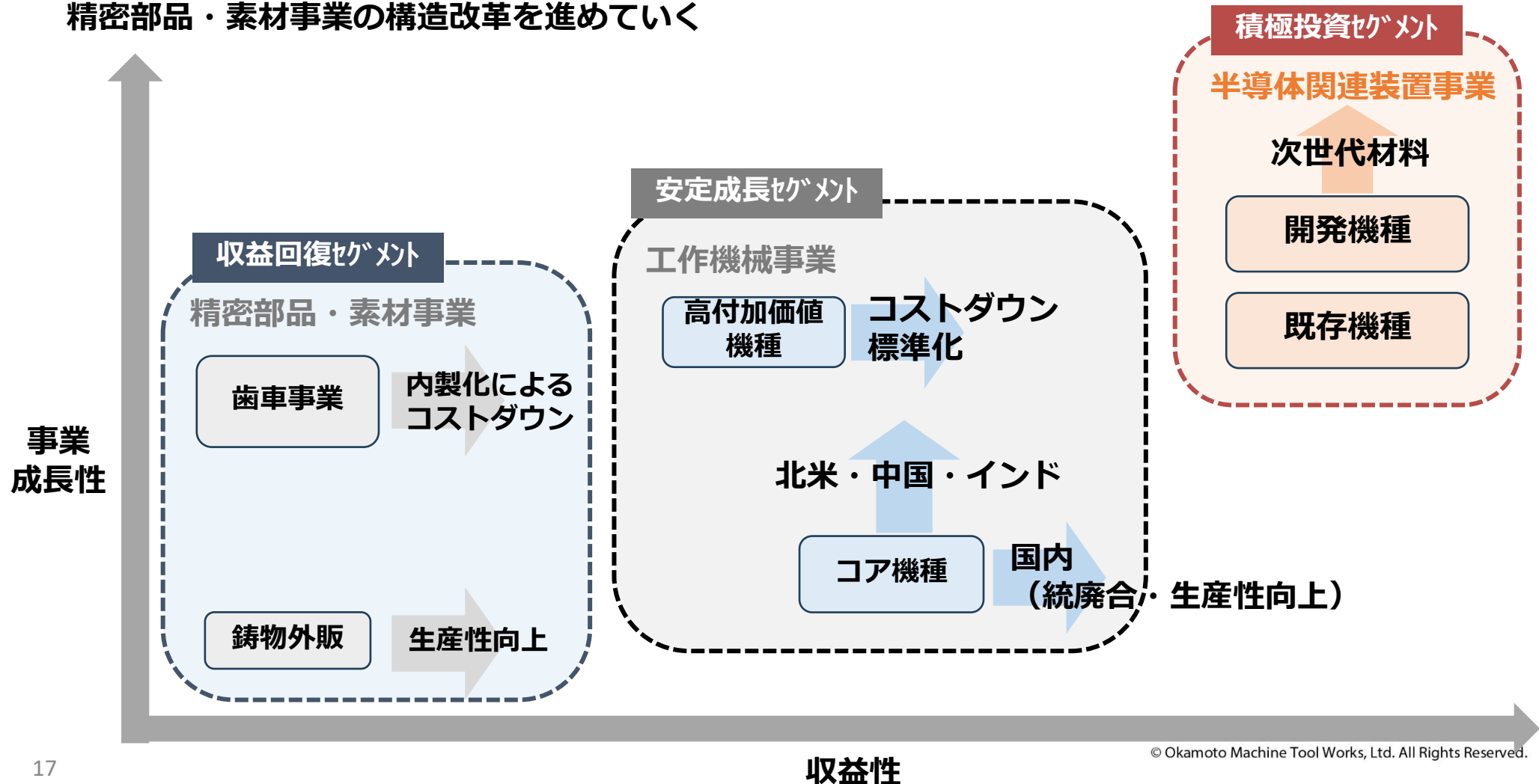
上期は計画未達に終わったが、基本的に下期に比重がかかる傾向  
目標達成に向け販売強化、コスト削減に努める



## 3. 中期経営計画“INFINITY700” 進捗状況

# 中長期戦略 事業ポートフォリオ

- 中長期戦略では半導体関連装置事業を積極投資セグメントとして位置付け、次世代材料領域にて事業拡大を図る
- 工作機械事業では、収益性の高いコア機種での成長を図るとともに、高付加価値機種へのテコ入れ、精密部品・素材事業の構造改革を進めていく



# 半導体関連装置事業 中計戦略骨子

## 半導体 関連装置

### I .成長投資の検証・実行管理

(成長投資の実行と管理)

### II .半導体関連装置事業の収益力維持・向上

(先行開発、新市場開拓・シェア拡大の中で最大限採算を維持・向上、BwithBの推進)

#### ① Siウェハ向けポリッシャのシェア維持

- ・ 従来機に対し更なる生産性向上を実現する機種開発
- ・ 中国アフターサービスの充実
- ・ 東京テクニカルセンターの最大活用等

#### ② 次世代機種の新規開発

- ・ Siウェハ加工プロセス高度化対応、パワー半導体(SiC, GaN)、通信デバイス向(LT/LN)ウェハ対応のポリッシャ並びにグライндаの開発(競争力のある製品開発)

#### ③ 半導体装置に関連した技術開発棟の新設、ショールームの刷新

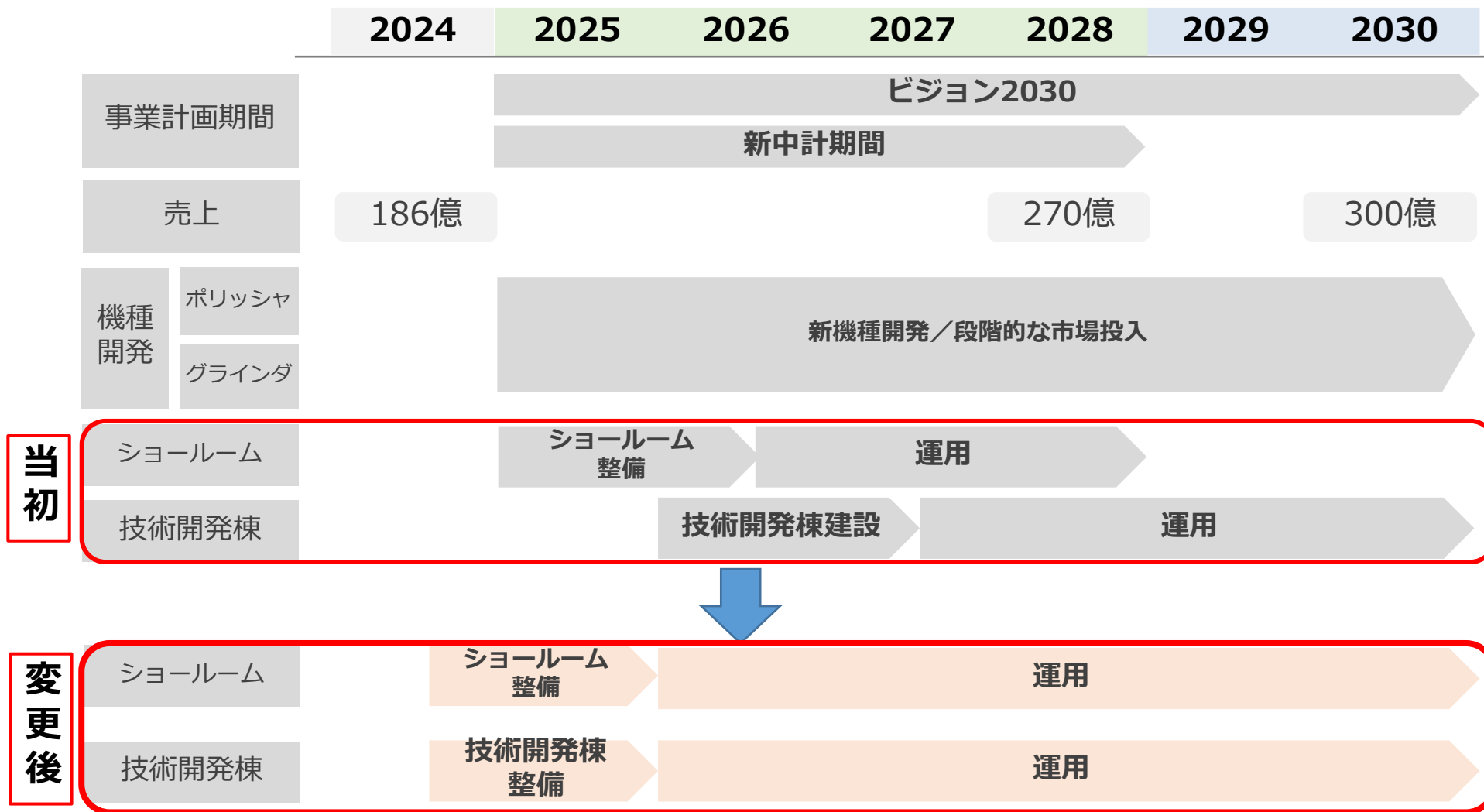
- ・ 技術的な要求に対する実証試験を通した受注確度の向上、並びにデモ機での設計・製造品質の作りこみ

#### ④ 設計・製造キャパシティの強化

- ・ 投資含め、売上300億円を支える生産体制の構築
- ・ 九州テクニカルセンターによる売上拡大
- ・ 必要人員の増員、必要フロアの確保

# 半導体関連装置事業 ロードマップ

ショールーム・技術開発棟（東京テクニカルセンター）は2025年12月より運用開始



# 半導体関連装置事業 東京テクニカルセンター①

さいたま市に2025年12月、東京テクニカルセンターを開設



東京テクニカルセンター



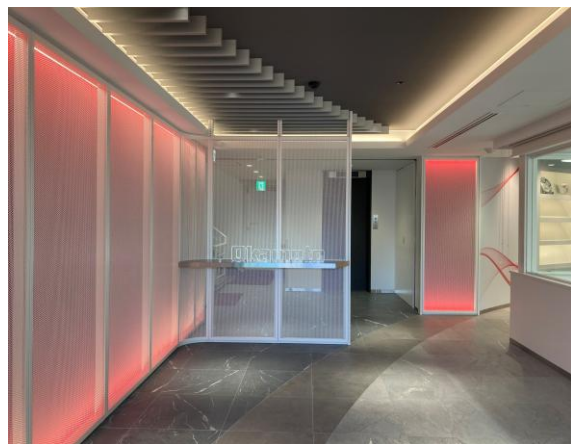
1. 最新装置の紹介
2. テスト加工
3. 設計製造へのフィードバック
4. 長期耐久試験
5. 市場情報の収集の拠点

トータルソリューションの視点から、  
ユーザーや協業メーカーを巻き込んだ  
砥石など副資材の開発  
新規プロセスの開発  
実機によるオペレーション&メンテナンストレーニング  
研修センターとしても活用を予定



# 半導体関連装置事業 東京テクニカルセンター②

Si貫通関連電極ウェーハ全自動研削装置のデバイス適用など先端技術を磨く拠点に



エントランス



PRコーナー

**SEMICON JAPAN 2025** 2025年12月17日(水)~19日(金)  
10:00~17:00 東京ビッグサイト(東展示棟)

**出展のご案内**  
Booth No. **E4208**

**革新を磨く。未来を削り出す。  
OKAMOTOの総合提案力**

2025年12月  
東京テクニカルセンターオープン!

先端半導体デバイスの  
総合砥粒加工装置メーカー  
**Okamoto**

PLP専用  
グラインダー・  
ポリッシャー

各種半導体材料  
インゴット  
無人研削システム

化合物半導体ウェーハ専用  
グラインダー・ポリッシャー

**Okamoto** ナノプロセスグループ  
株式会社 岡本工作機械製作所 〒379-0135 群馬県安中市郷原2993 TEL 027-385-6211, FAX 027-385-1144  
https://www.okamoto.co.jp



展示場



会議室

# 半導体関連装置事業 半導体市場開発部創設

2025年7月 「要素技術開発課」「プロセス技術開発課」からなる半導体市場開発部を創設  
半導体技術者の中途採用も強化

## 要素技術開発課

- ・ 半導体市場展開に不可欠な「要素」の開発を担当
- ・ 革新的な新技術、プロセス、ポリッシャーヘッドなど最重要部品、砥石、研磨パッド、スラリーなどの副資材の開発を目指す

## プロセス技術開発課

- ・ お客様の装置購入に直結する「加工テスト・デモ」を軸とした活動
- ・ 砥石など副資材や加工レシピといったプロセス連動型のトータルソリューションを追求

# 半導体関連装置事業 半導体開発機種

## ⚙️ ファイナルポリッシャーPNX332 B、C、CII

- 300mmファイナルポリッシャーのベストセラー
- 3テーブルあるポリッシュステージで、中研磨から仕上げ研磨まで 1テーブルあたり2枚同時研磨することで、装置1台あたり 6枚のウェーハを同時研磨可能
- インデックス搬送方式採用のため 残り2ヘッドでウェーハのロード/アンロードが可能となり、高生産を実現



## ⚙️ 高生産性SiCウェーハポリッシャーPNX232

- 3ポリッシュテーブル、8ポリッシュヘッドで6枚同時研磨可能
- 高速高圧ポリッシュ可能、ポリッシュレート安定化に各種センサー搭載



## ⚙️ 全自動LT/LNウェーハ枚葉ポリッシャーPNX200L

- LT(タンタル酸リチウム)LN(ニオブ酸リチウム)、各種接合基板対応ポリッシャー
- 加工目的に応じてあらゆるポリッシュヘッドの搭載が可能





# 半導体関連装置事業 半導体開発機種

## ⚙️ 高精度シングルチャックグラインダーGNX211

- 300mm対応、世界最小、高出力高剛性1スピンドル1テーブルグラインダー



## ⚙️ 200mm オートグラインダーGNX200BH

- 難削材料(SiC,GaN)向け高性能グラインダー



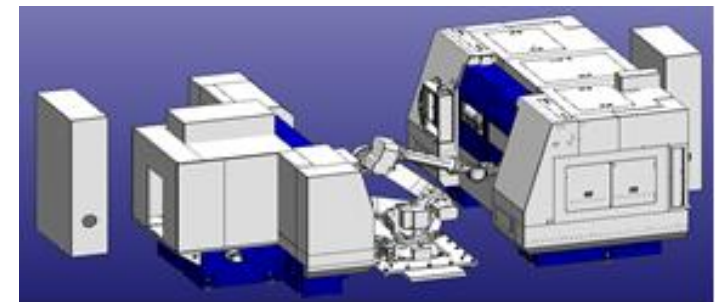
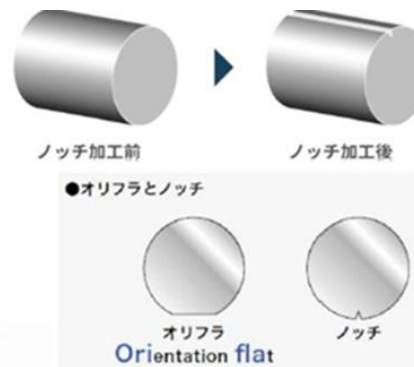
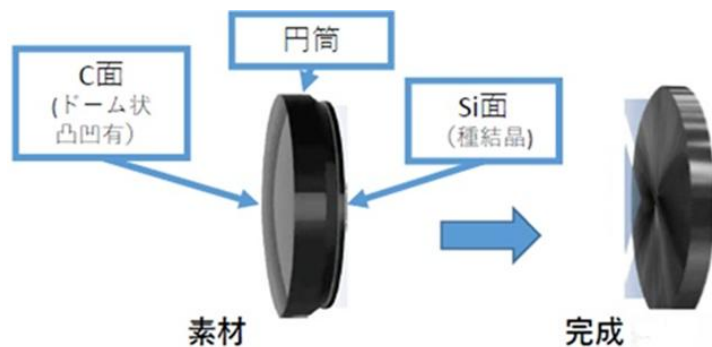
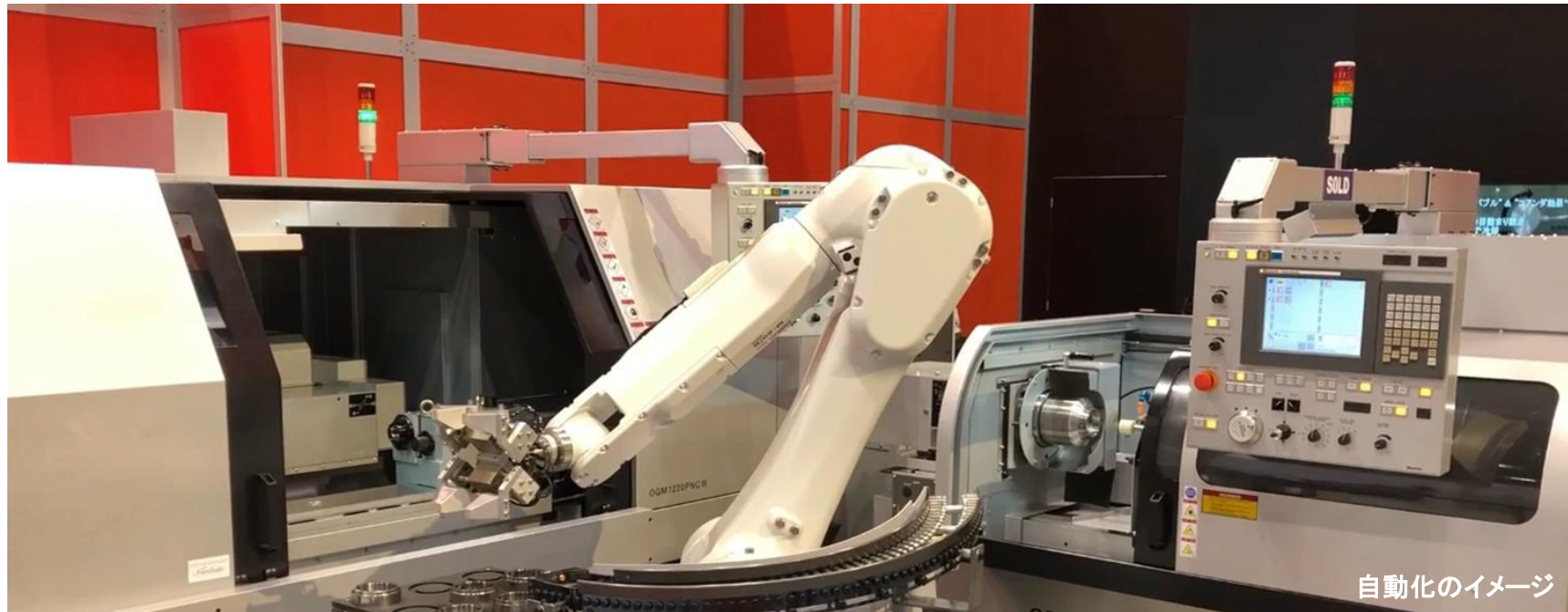
## ⚙️ 難削材料向けマニュアルグラインダーVG401H

- 大型・難削材・特殊材料に柔軟に対応可能なグラインダー



# 半導体関連装置事業 半導体開発機種

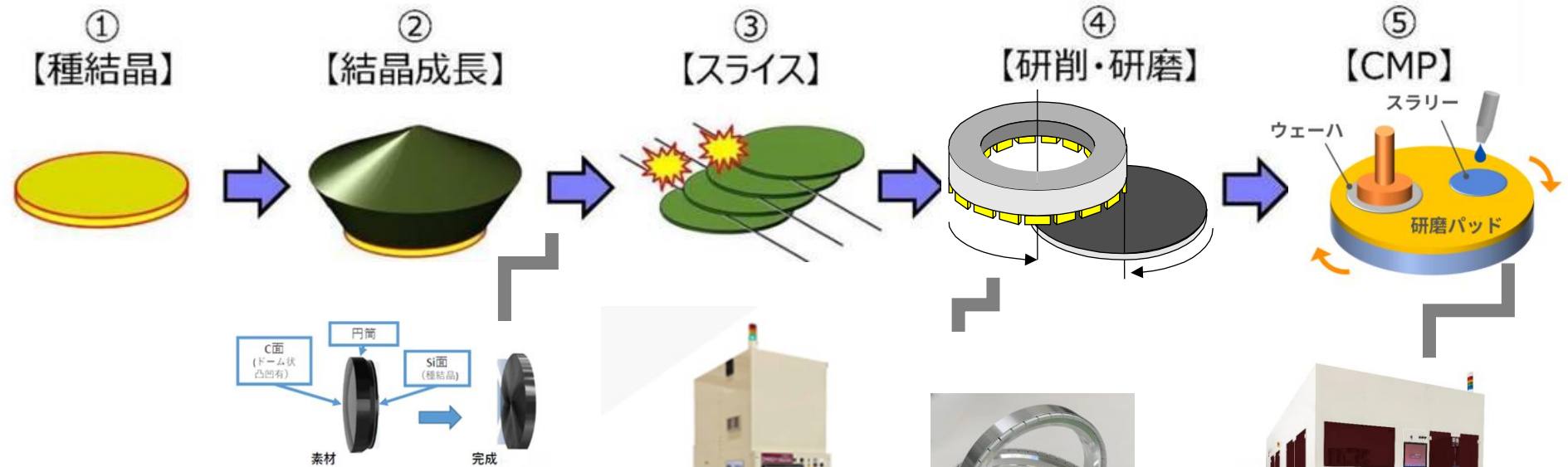
## ⚙️ 全自動SiCインゴット研削システム



© Okamoto Machine Tool Works, Ltd. All Rights Reserved.

# 半導体関連装置事業 半導体開発機種

## ⚙️ 化合物半導体プロセスにおけるトータルソリューションのご提案



【全自動SiCインゴット円筒研削システム】



GNX211  
【高剛性高精度グラインダー】



【高性能砥石開発】



PNX232  
【高生産性高圧ポリッシャー】



## 半導体関連装置事業

## 販売強化・三井物産との連携

## 【日本】

三井物産国内拠点を通じた  
グライндаなどの  
新規顧客開拓を展開

## 【台湾】

台湾三井物産と連携し、  
消耗品、メーカー、現地装置メーカー  
を巻き込んだ  
WSS（ウェーハ・サポート・システム）  
工程開発を開始

# 工作機械事業 中計戦略骨子

## 工作機械

### I. 成長市場での市場シェア拡大

(中国・アメリカでの売上拡大、インド市場開拓)

### II. 工作機械事業の収益力改善

(機械本体収益改善、BwithB推進)

#### ① 機械採算管理・売価見直し

グローバルでの機種別採算管理と、機種統合・再構築（値付け・開発含め）を推進。また、価値に応じた適正価格を追求

#### ② コア機種拡販（海外/国内）

コア機種である平面研削盤を中心とした、北米・中国・インド展開。市場に適応した機種の拡販を進める

#### ③ VE・設計標準化

過去の低採算機種の分析を踏まえ、標準化を徹底していく。また、新機種開発の中でVE推進し、既存機種へ展開しコスト低減を図る

#### ④ 国内生産・サービス強化投資

生産革新（OPS・直送化等）による品質向上・コスト低減、自動倉庫投資含めたBwithBの推進

**【東南アジア】**

ベトナム三井物産からの紹介  
先へ三井物産マシンテックと  
連携し、ローラー営業を開始

**【日本】**

三井物産との連携を強化  
大手ユーザーや  
休眠ユーザーの  
掘り起こしを開始

**【インド】**

大手日系ユーザーなど  
インド三井物産からの  
紹介先への営業を開始

**【北米】**

Ellison を通じ営業販売エリアを拡大  
上期、既に受注実績を獲得  
月例会議の開催や10月以降  
各州で開催のEllisonオープンハウスに  
展示機を手配

# <ご参考> 米Ellison Technologies, Inc.

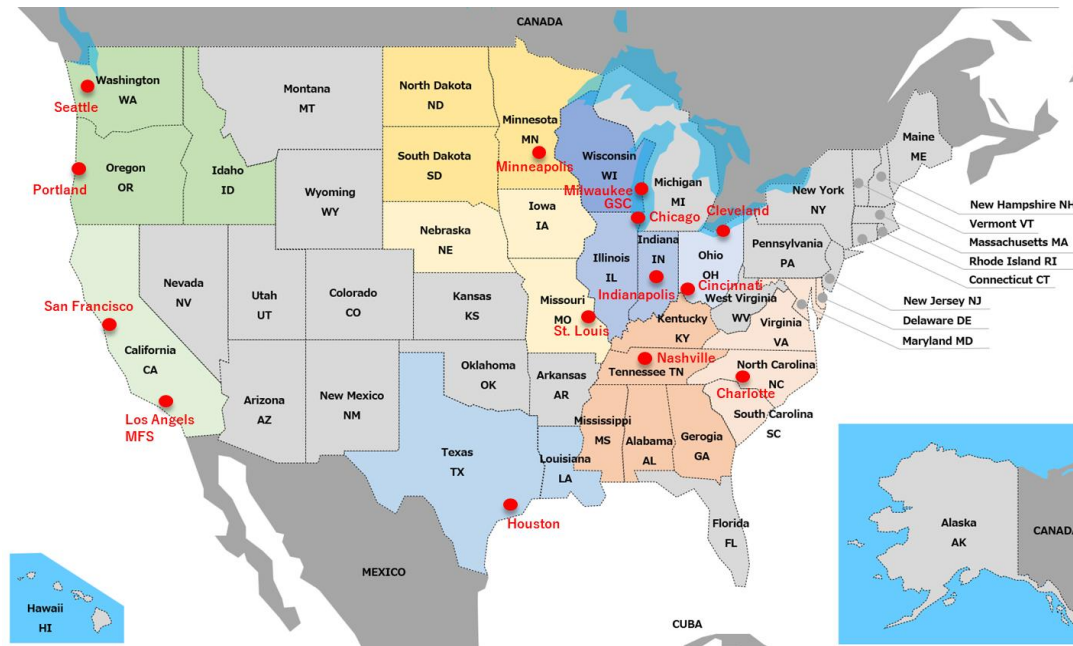
## 会社概要

会社名	Ellison Technologies, Inc. (略称: Ellison)
事業内容	工作機械等の販売及びサービス
創立	1955年
売上高	338million USD(2024年3月期)
人員	392名(2024年10月末日時点)
株主	三井物産100%

## 特徴

1. 工作機械の販売会社として全米最大手の一角
2. DNS代理店として世界No.2
3. 機械単体売りではなく、Turnkey Solutionを提供
4. 幅広い産業、大手から町工場までをカバー

### 販売地域 (26州で事業展開)



● Ellison支店所在地

出所：三井物産提供資料より



# 精密部品・素材（歯車・鋳物（外販））事業 中計戦略骨子

## 精密部品・素材 （歯車・ 鋳物（外販））

### I. 歯車事業 安定収益体制構築

（事業の幅を横に広げながら、内製化推進・組織強化を図る）

### II. 鋳物事業モノづくり改善/外販推進

（収益改善に向けた不良率低減・生産性の向上）

#### ① 【歯車】 高付加価値製品の拡販

強みを生かした高付加価値製品の拡販/技術向上を通し、業界内でのポジションを高め、より安定した売上を確保できる体制を構築する

#### ② 【歯車】 府中第二工場（新工場）での内製化推進

新工場投資により増加した生産キャパシティの有効活用（内製化） ・ 高い生産性の実現

#### ③ 【歯車】 安定した収益を確保できる体制の構築

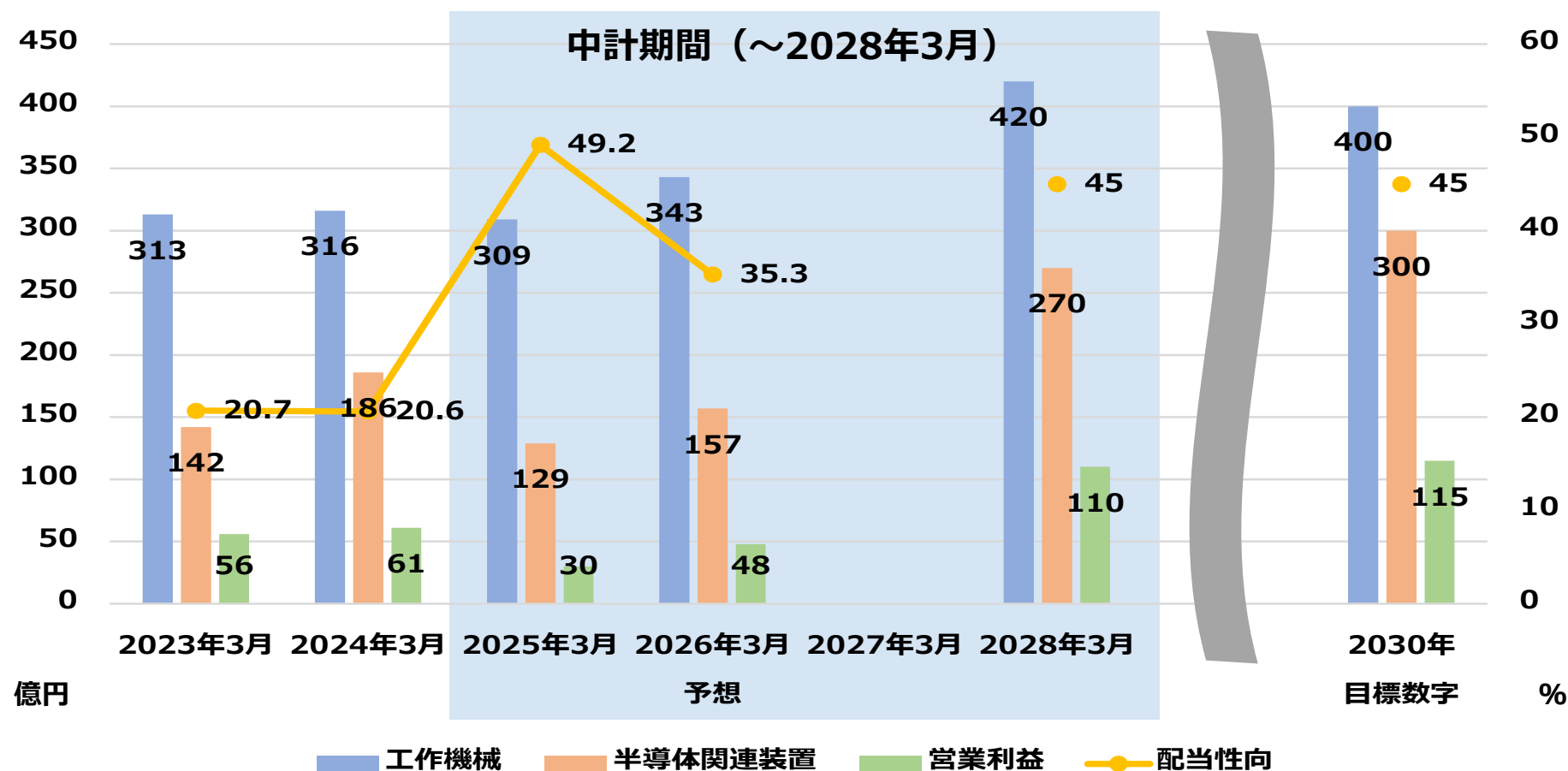
採算管理・計数管理体制の強化と、先回りした施策実行（価格コントロール等）

#### ④ 【鋳物(外販)】 生産体制強化・外販推進

安定品質・安定生産を実現するための技能伝承及び、人員採用。特に木型の開発、生産技術のレベルを維持・向上させていく体制づくり/新規顧客の開拓による売上高の拡大（外販）

# 新中計数値目標

2028年3月期に「ビジョン2030」で掲げた数値目標水準への到達を目指す  
また、2028年3月期45%の配当性向を目指す





# Appendix

## (ご参考資料)

# 世界唯一の総合砥粒加工機メーカー



## 会社概要

会社名 英文	株式会社 岡本工作機械製作所 Okamoto Machine Tool Works, Ltd.
創業	大正15年11月
設立	昭和10年6月
資本金	97億8,370万円
本社所在地	〒379-0135 群馬県安中市郷原2993番地
事業内容	<p>【工作機械・半導体関連装置の製造・販売】</p> <p>工作機械事業（平面研削盤・成形研削盤・内面研削盤・円筒研削盤・ 歯車研削盤・専用研削盤・精密歯車・鋳物）</p> <p>半導体関連装置事業（グライデイングマシン・スライディングマシン・ホーリングマシン・ラッピングマシン・ガラス基板研磨装置）</p>
従業員数	連結: 2,252名 単体: 500名 ※2025年9月末現在



## 国内拠点、海外拠点





# 半導体関連装置事業 九州地区半導体関連拠点

半導体関連企業が集積する九州に戦略的に拠点を配置・強化中

伊万里市  
九州テクニカルサポートセンター



お客様のサポートをより近くで可能に  
パーツ対応やメンテナンスを担当



半導体分野での自動化に実績

嘉島町  
プレシード



都城市  
大和工機

大型のクリーンルームを活用し、  
高硬度材向けグライNDERの生産体制を構築中

2023年5月	九州テクニカルサポートセンター 開設
2023年5月	プレシード資本業務提携
2023年11月	大和工機 完全子会社化

## 本資料に関するお問い合わせ先

**株式会社 岡本工作機械製作所**  
**総務部**

**TEL 027(385)5800**

### 【本資料お取扱い上のご注意】

本資料は、株式会社岡本工作機械製作所（以下、当社）をご理解いただくため、当社が作成したもので、当社への投資活動勧誘を目的としておりません。

本資料を作成するにあたっては正確性を期すために慎重に行っておりますが、完全性を保証するものではありません。本資料中の情報によって生じた障害や損害については、当社は一切責任を負いません。

本資料中の業績予測ならびに将来予測は、本資料作成時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、事業環境の変化等の様々な要因により、実際の業績は言及または記述されている将来見通しとは大きく異なる結果があります。